

半導体関連機器リスト

2024年3月11日

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所
半導体プロセス、洗浄			
A001	UV・オゾンクリーナー(CMOS用)	サムコ・Model UV-300	固体機能デバイス
A002	UV・オゾンクリーナー(センサ/MEMS用)	サムコ・Model UV-1	VBL 1F
A003	バッチ式Siウエハ洗浄装置	CWC・4+4M	固体機能デバイス
A004	超臨界洗浄・乾燥装置	レクザム・SCRD4	VBL 1F
半導体プロセス、成膜			
A005	CMOS用Alスパッタ装置	アネルバ・直流スパッタシステム	固体機能デバイス
A006	マルチターゲットRF/DCスパッタ装置 (CMOS用)	キャノンアネルバ・E-400S	固体機能デバイス
A007	酸化膜用スパッタ装置	キャノンアネルバ・E-200S	VBL 1F
A008	イオンコータ	アルバック機工・VPS-050	固体機能デバイス
A010	プラズマCVD装置 (CMOS用)	サムコ・PD-220M	VBL 1F
A011	プラズマCVD装置 (MEMSデバイス用)	サムコ・PD-220NS	VBL 1F
A012	リフロー用プラズマCVD装置 (CMOS用)	サムコ・PD-220NLM	固体機能デバイス
A013	LPCVD装置 (CMOS用)	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	固体機能デバイス
A014	LPCVD装置 (MEMS用)	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	固体機能デバイス
A015	パリレンコータ	日本パリレン・PDS2010	VBL 1F
A016	高真空蒸着装置	サンバック・Ed-1600	EIIRIS 1F
A017	機能性絶縁膜堆積装置(PECVD装置)	住友精密工業・Cetus	VBL1F
半導体プロセス、酸化・熱処理			
A018	CMOS用 酸化・アニール炉	光洋リンドバーグ・MODEL272H-300H15X070H	固体機能デバイス
A019	水素アニール炉 (CMOS用)	光洋サーモシステム・KTF773N-AS	VBL 1F
A020	水素アニール炉 (Si汎用)	光洋リンドバーグ・272M-200H15X070H	固体機能デバイス
A021	2段酸化炉 (Al ₂ O ₃ /Si基板用、Si汎用)	光洋サーモシステム	VBL 1F
A023	リン拡散炉	光洋リンドバーグ・272M-200H15X070H	固体機能デバイス
半導体プロセス、イオン注入			
A024	イオン注入装置	日新イオン機器・EXCEED2300SDV	固体機能デバイス
半導体プロセス、リソグラフィ			
A025	i線ステッパ	ニコンテック・NSR-TFHi12CH	固体機能デバイス
A026	コンタクトマスクアライナ (2インチ自動ローディング)	キャノン販売・PLA-501(F)	固体機能デバイス
A027	コンタクトマスクアライナ (2インチ自動ローディング)	キャノン・PLA-501(F)	固体機能デバイス
A028	コンタクトマスクアライナ (2インチ手動ローディング)	キャノン・PLA-501	固体機能デバイス
A029	コンタクトマスクアライナ (4インチ手動ローディング)	キャノン・PLA-600	固体機能デバイス
A030	両面アライナ	SUSS・Micro Tec AG	固体機能デバイス
A031	EB描画装置	日本電子・JBX-6300DA	固体機能デバイス
A032	i線用レジスト塗布・現像装置	ASAP・PRD4-000-07-2	固体機能デバイス
A034	レジストアッシング装置 (CMOS用)	サムコ・PC-1100	VBL 1F
A035	レジストアッシング装置 (MEMS用)	サムコ・Model PX-250M	VBL 1F

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所
A036	微細パターン高速形成装置(マスクレス描画装置)	大日本科研・MX-1205	固体機能デバイス
半導体プロセス、加工・エッチング			
A037	集束イオンビーム加工装置 (FIB)	エスアイアイ・ナノテクノロジー・SMI3200TS	VBL 1F
A038	反応性イオンエッチング装置 (MEMS F系ガス用)	サムコ・RIE-200F	VBL 1F
A039	反応性イオンエッチング装置 (MEMS Cl系ガス用)	サムコ・RIE-200NL	VBL 1F
A040	反応性イオンエッチング装置 (CMOS F系ガス用)	アネルバ・L-451D-L	固体機能デバイス
A041	反応性イオンエッチング装置 (CMOS Cl系ガス用)	アネルバ・L-451D-L	固体機能デバイス
A042	Si深堀りエッチング装置 (Deep-RIE)	住友精密工業・MUC21-RD	VBL 1F
A043	誘導結合型反応性イオンエッチング装置 (ICP-RIE)	アルバック・CE-300I	VBL 1F
A044	Siエッチング装置 (XeF2ガス)	Xactix・Xetech E1-β	VBL 1F
A045	集積化センサ加工装置(ICPRIE装置)	住友精密工業・Sirius	VBL1F
半導体プロセス、後工程			
A046	Siウエハ用レーザーダイシング装置	東京精密・ML200	固体機能デバイス
A047	ダイシングソー	東京精密・A-WD-10A	VBL 1F
A048	ワイヤーボンダー (Au)	ハイソル・West bond 7700D-79	固体機能デバイス
A049	ワイヤーボンダー (Al)	ハイソル・West bond 7476D	固体機能デバイス
半導体プロセス、観察・評価			
A050	CLSM : レーザー顕微鏡	オリンパス・OLS3100	固体機能デバイス
A051	SEM : 測長機能付き走査型電子顕微鏡	日本電子・JSM-7100F	固体機能デバイス
A052	温度可変プローバ・計測器システム	ハイソル	固体機能デバイス
A053	ウエハプローバ・計測器システム	東京精密・A-PM-50A、 アジレント・4155C	固体機能デバイス
A054	光干渉膜厚計	大日本スクリーン製造・VM-1230	固体機能デバイス
加工・エッチング			
A055	FIB : 集束イオンビーム装置	日立ハイテクノロジーズ・NB5000	EIIRIS 2F 共同研究室5
観察・評価			
A056	CLSM : 正立型共焦点顕微鏡	ニコン・A1rsi-TY	EIIRIS 2F バイオ実験室
A057	SEM : EDS付走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ・S-3000N: Thermo Fisher・NORAN SYSTEM SIX	EIIRIS 2F 共同研究室5
A058	デジタルマイクロスコープ	キーエンス・VHX-500	EIIRIS 2F 共同研究室5
分光分析			
A059	高速イメージング顕微ラマン分光システム	日本分光・NRS-7100	EIIRIS 2F 共同研究室5
A060	PL(フォトルミネッセンス)/RAMAN 測定装置	HORIBA Jobin Yvon・LabRAM HR-800	EIIRIS 2F 共同研究室5